

センサー用封止材料


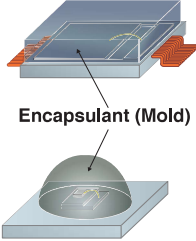
Encapsulation materials for sensor devices

低透湿(対車載)高透明

Low moisture permeation, high-transparency

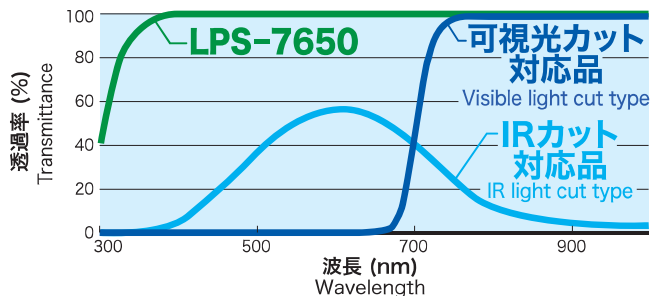
IR/可視光カット対応(ポッティング/成形材料)

IR light/Visible light cut type (potting/molding)

	LPS-7650	KJC-X5
樹脂系 Resin type	シリコン系 Silicone	エポキシ系 Epoxy
プロセス Process	ディスペンス Dispense	トランスファー成型 Transfer Molding
デバイス例 Example		
Tg (°C)	145	167
ヤング率 (GPa) Young's modulus	1.5	2.7
強度 (MPa) Flexural strength	55	90

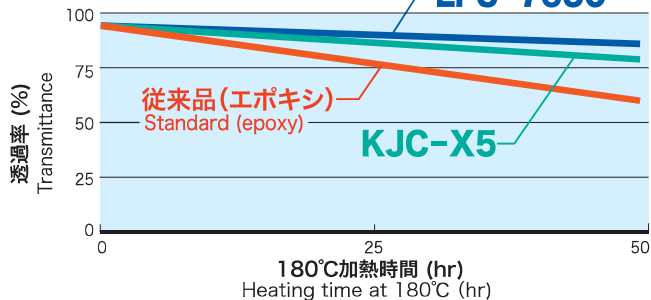
光透過性 (1mm)

Transmittance



耐熱性

Heat-resistance



位置ずれ防止接着剤

Lid seal adhesive materials

硬化時の位置ずれを抑制

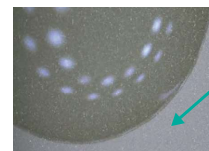
Prevent positional displacement of glass at cure process

	KJC-7810	SMC-770B
樹脂系 Resin type	ブリードレスシリコン Bleed-less silicone	エポキシ系 Epoxy
硬化条件 Cure condition	1500mJ/cm ² + 80°C2hr	100°C4hr

Typical UV cure silicone



KJC-7810



No bleed
Substrate type:
Ag, Au, Ni/Pd/Au,
Al₂O₃

